

Соотношения (5)–(9) справедливы для всего класса узкозонных полупроводниковых соединений $A^{IV}B^{VI}$ p -типа, для которых выполняются условия $\mu_n/\mu_p \gg 1$ и $N_D/N_A \ll 1$.

Таким образом, в данном сообщении разработан метод, позволяющий определять как значения n , μ_n , так и величину $x(n_i)$, характеризующую состав соединения $A^{IV}B^{VI}$ p -типа, по значениям $R_H(B)$ и $\sigma(B)$ для двух фиксированных величин слабого магнитного поля $B \sim 1$ кГс.

Авторы признательны А. В. Васильеву и Л. С. Смирнову за интерес к работе и полезные обсуждения.

Список литературы

- [1] Faurie J. P., Reno J., Sivananthan S., Sou I. K., Chu X., Boukerche M., Wijewarnasuriya R. S. // J. Vac. Sci. Techn. 1986. V. A4. N 4. P. 2067–2071.
- [2] Георгоблани А. Н., Шейнкман М. К. Физика соединений $A^{IV}B^{VI}$. М., 1986. 320 с.
- [3] Gold M. C., Nelson D. A. // J. Vac. Sci. Techn. 1986. V. A4. N 4. P. 2040–2046.
- [4] Lacklison D. E., Capper P. // Semicond. Sci. Techn. 1987. V. 2. N 3. P. 136–144.
- [5] Блатт Ф. Физика электронной проводимости в твердых телах. М., 1971. 470 с.
- [6] Цидильковский И. М. Бесщелевые полупроводники — новый класс веществ. М., 1986. 240 с.
- [7] Finkman E., Shachman S. E. // J. Appl. Phys. 1984. V. 56. N 10. P. 2896–2900.
- [8] Hansen G. L., Schmit J. L. // J. Appl. Phys. 1983. V. 54. N 3. P. 1639–1640.
- [9] Summers C. J., Darling B., Martin B. G. // Appl. Phys. 1986. V. 59. N 7. P. 2457–2466.

Институт физики полупроводников
СО АН СССР
Новосибирск

Получено 11.10.1990
Принято к печати 7.02.1991

ФТП, том 25, вып. 6, 1991

ОХЛАЖДЕНИЕ ДВУМЕРНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГАЗА ЗАТВОРОМ МДП СТРУКТУРЫ

Бойко И. И., Шик А. Я.

В теоретических работах, посвященных эффектам разогрева в двумерном газе (2МЭГ), обычно считается, что релаксация энергии осуществляется, как и в массивных образцах, за счет фононов. Однако в 2МЭГ, созданном в инверсионном канале МДП структур, существует еще один возможный механизм энергетических потерь. Он связан с передачей энергии электронам металлического затвора за счет кулоновского взаимодействия через диэлектрик [1, 2]. Далее строится теория такого механизма энергетической релаксации в вырожденном 2МЭГ.

В своих вычислениях мы будем исходить из общих формул для рассеяния 2МЭГ на полуограниченной трехмерной электронной системе, полученных в [3, 4]. Если полную диэлектрическую проницаемость системы записывать в виде

$$\epsilon(\omega, \mathbf{q}) = \epsilon_s(\omega, \mathbf{q}) + \Delta\epsilon_2(\omega, \mathbf{q}), \quad (1)$$

где первый член описывает вклад всей системы, окружающей 2МЭГ, а второй — добавку за счет самого 2МЭГ, то скорость энергетических потерь будет определяться выражением

$$Q = \frac{\hbar}{(2\pi)^3 n_2} \int \omega d\omega \int d^2\mathbf{q} \frac{\text{Im } \epsilon_s(\omega, \mathbf{q}) \text{Im } \Delta\epsilon_2(\omega, \mathbf{q})}{|\epsilon(\omega, \mathbf{q})|^2} \left[\text{cth} \left(\frac{\hbar\omega}{2T_s} \right) - \text{cth} \left(\frac{\hbar\omega}{2T} \right) \right] \quad (2)$$

(n_2 — поверхностная концентрация 2МЭГ). При выводе (2) предполагалось, что 2МЭГ и трехмерные электроны затвора характеризуются фермиевскими

функциями распределения соответственно с эффективной температурой T_e и с температурой решетки T ($T_e > T$).

Общее выражение для $\Delta\varepsilon_2$ вырожденного 2МЭГ в литературе известно (см., например, [5]). Поскольку в рассматриваемой задаче передача энергии $\hbar\omega \ll T_e$ (см. далее), в вырожденном 2МЭГ всегда реализуется предел $\hbar\omega \ll \ll \frac{(\hbar k_F)^2}{2m}$ (k_F — фермиевский импульс 2МЭГ), для которого

$$\Delta\varepsilon_2(\omega, \mathbf{q}) \cong \frac{2me^2}{\hbar^2 q} \left\{ 1 + i \frac{m}{\hbar q} \left[\sqrt{\left(\frac{\hbar k_F}{m}\right)^2 - \left(\omega - \frac{\hbar q^2}{2m}\right)^2} - \sqrt{\left(\frac{\hbar k_F}{m}\right)^2 - \left(\omega + \frac{\hbar q^2}{2m}\right)^2} \right] \right\}. \quad (3)$$

Вид $\varepsilon_s(\omega, \mathbf{q})$ определяется геометрией системы. Если речь идет об МДП структуре, в которой диэлектрик имеет толщину d и диэлектрическую проницаемость ε_d , а полупроводник проницаемость ε , то, как показано в [3],

$$\varepsilon_s(\omega, \mathbf{q}) = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon_d}{2} \frac{\beta(\omega, \mathbf{q}) \operatorname{th}(qd) + 1}{\beta(\omega, \mathbf{q}) + \operatorname{th}(qd)}. \quad (4)$$

Здесь $\beta(\omega, \mathbf{q})$ характеризует материал затвора, который всегда имеет толщину, много большую длины экранирования, и потому может считаться полубесконечным и описываться диэлектрической функцией массивного металла $\varepsilon_3(\omega, \mathbf{k})$. При этом

$$\beta(\omega, \mathbf{q}) = \varepsilon_L \frac{q}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk_z}{(q^2 + k_z^2) \varepsilon_3(\omega, \sqrt{q^2 + k_z^2})} \quad (5)$$

(ε_L — решеточная диэлектрическая проницаемость в материале затвора).

Формулы для $\varepsilon_3(\omega, \mathbf{k})$ можно найти, например, в [6]. В них входит, в частности, параметр $\omega/v_{3F}k$, где v_{3F} — фермиевская скорость трехмерных электронов затвора. Если материал затвора — хороший металл (а не, скажем, поликремний), то v_{3F} существенно превосходит фермиевскую скорость 2МЭГ $\hbar k_F/m$, так как, согласно (3), $\operatorname{Im} \Delta\varepsilon_2$, а следовательно, и подынтегральное выражение в (2) отлично от нуля лишь при $\hbar k_F q > m\omega$, то $\omega \ll kv_{3F}$, т. е. для электронов затвора реализуется предел малых ω . В данном пределе

$$\varepsilon_3(\omega, \mathbf{k}) \cong \varepsilon_L \left[1 + \frac{x^2}{k^2} \left(1 + i \frac{\pi}{2} \frac{[\omega]}{kv_{3F}} \right) \right] \quad (6)$$

($x = \frac{\sqrt{3}\Omega}{v_{3F}}$ — обратная длина экранирования, Ω — плазменная частота). При этом для $x \gg q$

$$\beta(\omega, \mathbf{q}) = \frac{q}{x} \left[1 - i \frac{\omega}{v_{3F}x} \ln\left(\frac{x}{q}\right) \right]. \quad (7)$$

Выражения (3)—(7), будучи подставлены в (2), позволяют, в принципе, вычислить интересующую нас скорость энергетических потерь. Однако для получения результатов в аналитическом виде необходимы дальнейшие упрощения. Для их получения заметим, что типичное значение длины экранирования в металле составляет единицы ангстрем, величина эффективного экранирования радиуса в полупроводнике $a_B = \varepsilon \hbar^2 / me^2$ — десятки ангстрем, в то время как типичная толщина диэлектрика в МДП структуре имеет порядок 1000 Å. Кроме того, далее будет показано, что характерные значения переданного импульса q , определяющие скорость потерь Q , имеют порядок d^{-1} . В результате для большинства реальных структур

$$q \sim d^{-1} \ll a_B^{-1} \ll x. \quad (8)$$

Данные неравенства оправдывают законность предположения $q \ll x$, сделанного при выводе формулы (7). Кроме того, из них следует, что $|\beta| \sim q/x \ll \text{th}(qd) < 1$, в результате чего из (4) и (7) получаем

$$\text{Re } \varepsilon_s \cong \frac{1}{2} (\varepsilon + \varepsilon_d \text{cth}(qd)) \ll \text{Re } \Delta \varepsilon_2 = \frac{2\varepsilon}{a_{Bq}}; \quad \text{Im } \varepsilon_s \cong \frac{\varepsilon_d}{2v_{3F}\lambda^2} q\omega \ln\left(\frac{x}{q}\right) \text{sh}^{-2}(qd). \quad (9)$$

С учетом всего сказанного выражение (2) принимает вид

$$Q = \frac{\hbar^2 \varepsilon_d}{8\pi^2 e^2 n_2 v_{3F} \lambda^2} \int_0^\infty d\omega \omega^3 \left[\text{cth}\left(\frac{\hbar\omega}{2T_s}\right) - \text{cth}\left(\frac{\hbar\omega}{2T}\right) \right] \times \\ \times \int \frac{dq q^2}{\sqrt{k_F^2 - \left(\frac{m\omega}{\hbar q} + \frac{q}{2}\right)^2}} \frac{\ln(x/q)}{\text{sh}^2(qd)} \Theta\left(k_F - \frac{m\omega}{\hbar q} - 0.5q\right) \quad (10)$$

[$\Theta(x)$ — единичная функция]. Анализируя данное выражение, видим, что, как уже говорилось выше, максимальная передача импульса в акте взаимодействия с электронами затвора определяется толщиной диэлектрика: $q \sim d^{-1}$. Что касается передачи энергии, то она может быть различной в зависимости от соотношений между параметрами задачи. Следует рассматривать два различных предельных случая.

а) $\hbar^2 k_F / mTd \ll 1$. Здесь передача энергии $\hbar\omega \sim \hbar^2 k_F / md$, т. е. определяется максимально возможным изменением энергии электрона с поверхности Ферми при изменении его импульса на \hbar/d . Поскольку $\hbar\omega \ll T$, разность гиперболических котангенсов может быть заменена на $2(T_s - T)/\hbar\omega$. При этом получаем

$$Q = \frac{5}{4\pi} \zeta(5) \frac{\hbar^4 \varepsilon_d}{m^3 e^2 v_{3F} \lambda^2 d^5} \ln(xd) (T_s - T). \quad (11)$$

б) $\hbar^2 k_F / mTd \gg 1$. Здесь максимальная передача энергии определяется тепловым размытием фермиевской ступеньки. В рассматриваемом случае нижний предел интегрирования по q можно с хорошей точностью считать нулем. В результате имеем

$$Q = \frac{\pi^{7/2}}{360 \sqrt{2}} \frac{\varepsilon_d}{\hbar^2 e^2 n_2^{3/2} v_{3F} \lambda^2 d^3} \ln(xd) (T_s^4 - T^4). \quad (12)$$

Комментируя полученные выше результаты, следует упомянуть также недавнюю работу [7], где в рамках несколько иного подхода рассматривалась сходная задача о релаксации импульса и энергии 2МЭГ на электронах затвора. Авторы ограничились условием слабой неравновесности. Если скорость энергетических потерь, вычисленную ими в расчете на один электрон затвора, пересчитать на один электрон 2МЭГ, то получаются результаты, согласующиеся с (11) и с линеаризованным по малой величине $T_s - T$ выражением (12).

Сравним рассмотренный нами механизм релаксации энергии 2МЭГ со стандартным фоновым механизмом. Последовательная теория последнего для деформационного взаимодействия с акустическими фононами построена в работах [8, 9]. С точки зрения качественного поведения наибольший интерес представляет зависимость скорости потерь Q от температуры электронов T_s и решетки T , а также от концентрации 2МЭГ n_2 . Согласно [8, 9], при сравнительно высоких температурах $Q_{\text{фон}} \sim n_2^{-1} (T_s - T)$, а в пределе низких температур и высоких концентраций 2МЭГ $Q_{\text{фон}} \sim n_2^{-3/2} (T_s^5 - T^5)$.

Видно, что рассмотренный кулоновский механизм релаксации в высокотемпературной области отличается иной зависимостью (вернее, независимостью) от n_2 , а в области низких температур отличается от фоновонного механизма иной зависимостью от T_s , т. е. иной степенью нелинейности разогрева. В силу последнего обстоятельства обязательно должна существовать область достаточно низких температур и не слишком сильных разогревов, где кулоновский механизм доминирует.

Оценки показывают, что для наиболее часто используемых в электронике кремниевых МДП структур с металлическими затворами и $d \cong 1000 \text{ \AA}$ почти всегда (за исключением предельно низких температур) доминирует фононный механизм энергетической релаксации. Однако благодаря очень сильной зависимости от d в формулах (11), (12), уменьшение толщины диэлектрика существенно увеличивает возможности наблюдения кулоновской релаксации. Другим способом усиления эффекта является уменьшение концентрации носителей в затворе n_3 . При этом возрастает длина экранирования κ^{-1} и уменьшается фермиевская скорость v_{3F} , что, согласно (11), (12), приводит к увеличению Q . Поэтому рассматриваемый нами эффект целесообразно наблюдать в МДП структурах не с металлическим, а с поликремниевым затвором или же в полевых транзисторах на основе гетероструктур (т. е. НЕМТ), где роль затвора играет легированный слой широкозонного материала.

Вопрос о зависимости скорости энергетических потерь от n_3 требует дополнительного обсуждения. Очевидно, что увеличивать Q путем уменьшения n_3 можно не беспредельно (при $n_3 \rightarrow 0$ релаксация отсутствует), и должно существовать некоторое оптимальное значение n_3^{opt} , при котором рассматриваемый механизм энергетических потерь наиболее эффективен. Для нахождения n_3^{opt} следует отказаться от упрощающих предположений, которые мы делали при выводе ϵ_s . Таких предположений два: $v_{3F} \gg \hbar k_F / m$ и ограничение снизу на толщину диэлектрика (8). Отказ от первого приведет к необходимости учета в $\text{Im } \epsilon_s$ [см. (6)] фактора $\Theta (\hbar v_{3F} - \omega)$,¹ что усложняет расчет β . Тем не менее в [3] были получены интерполяционные формулы для β , асимптотически точные в различных предельных случаях. Мы ограничимся низкотемпературным пределом б), когда изучаемый нами механизм энергетических потерь наиболее существен. Это означает, что соответствующие диэлектрические проницаемости следует рассматривать в пределе малых ω . При этом

$$\beta(\omega, \mathbf{q}) \cong \frac{q}{q + \kappa} \left\{ 1 - i \frac{\omega \kappa^2}{v_{3F} (q + \kappa)^3} [1 + \ln(1 + \kappa q)] \right\}. \quad (13)$$

Подстановка данного выражения в (4) и (2) дает при $d \gg a_B$, κ^{-1} для Q выражение (12), а при d , меньшей какой-нибудь из двух характерных длин a_B и κ^{-1} ,

$$Q \sim \frac{\epsilon_d \min \{ a_B^{-1}; x \}}{e^2 \hbar^2 n_3^2 v_{3F}} (T_0^4 - T^4) \quad (14)$$

[численный множитель в формуле не удается определить виду приближенного характера (13)]. Таким образом, оптимальный уровень легирования электронного слоя, на котором идет релаксация (мы намеренно избегаем слова «затвор», поскольку структура с малым n_3 уже не является в строгом смысле МДП транзистором), определяется из условия $\kappa a_B \approx 1$, т. е. равенства длин экранирования в двумерном и трехмерном электронном газе.

Список литературы

- [1] Price P. J. // Physica. 1983. V. 117B-118B. P. 750.
- [2] Jacoboni C., Price P. J. // Sol. St. Electron. 1988. V. 31. P. 649.
- [3] Бойко И. И., Сиренко Ю. Н. // Препринт ИП АН УССР. Киев, 1988. № 2-88.
- [4] Boiko I. I., Sirenko Yu. M. // Phys. St. Sol.(b). 1990. V. 159. P. 805.
- [5] Андо Т., Фаулер А., Стерн Ф. Электронные свойства двумерных систем. М., 1985. 416 с.
- [6] Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П. Физическая кинетика. М., 1979.
- [7] Laikhtman V., Solomon P. M. // Phys. Rev. B. 1990. V. 41. P. 9921.
- [8] Карпус В. // ФТП. 1986. Т. 20. В. 1. С. 12.
- [9] Xie Y. H., People R., Bean J. C., Wecht K. W. // Appl. Phys. Lett. 1986. V. 49. P. 283.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Получено 19.02.1991
Принято к печати 21.02.1991

¹ $\text{Re } \epsilon_s$ при этом также несколько модифицируется по сравнению с (6) (см. [3]), но это качественно не изменит результатов.